レジュメ（経歴及び今後の活動内容）

提出者氏名：

専門分類（業務経験上で特に専門とされる分類にチェックを入れて下さい）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **大分類** | [ ] 半導体プロセス | [ ] サブストレート | [ ] プリント配線板（ﾘｼﾞｯﾄﾞ/フレキ） |
| [ ] 設計 | [ ] 製造 | [ ] 実装 | [ ] 品質管理 |
| [ ] 経営 | [ ] 営業 | [ ] 調達 | [ ] 工場設営 |
| **小分類** | [ ] 設計：[ ] 部品データ設計（基板構造含む）[ ] 配線設計　[ ] CAM出力　[ ] シミュレーション　[ ] その他[ ] 製造：[ ] 資機材（材料、薬剤、装置等）[ ] TH加工（穴あけ、めっき等）[ ] 表面処理（OSP、金めっき等）[ ] 製造技術（積層プレス、パターン形成、ソルダレジスト等）[ ] 生産技術　[ ] その他[ ] 実装：[ ] 電子部品　[ ] 搭載・接合技術　[ ] その他[ ] 品質管理：[ ] 検査技術　[ ] 信頼性評価技術　[ ] 各種解析技術　[ ] 問題解決手法　[ ] 品質管理手法　[ ] クレーム対策技術　[ ] その他[ ] 半導体プロセス：[ ] 前工程　[ ] 後工程　[ ] その他[ ] 経営：[ ] 経営管理　[ ] 生産管理　[ ] 情報システム　[ ] その他[ ] 営業：[ ] マーケティング　[ ] 技術営業　[ ] その他[ ] 調達：[ ] 設備調達　[ ] 材料・部品調達　[ ] その他[ ] 工場設営：[ ] 基板製造装置設計　[ ] 設備仕様設計　[ ] その他[ ] その他（　　　　　） |

経歴の補足説明

1. これまで経験した業務の中で、自身が一番貢献できたもの

２．現在取り組んでいる課題

３．後進（部下及び後輩）の指導をどのようにしているか

**注意事項**

・経歴の補足として1～3の設問においてご記入下さい。

・今後の活動内容についてA4サイズ1枚以内でご記入下さい。

（★この注意項目は、レジュメ作成時に除去して下さい。）

経歴の補足説明

今後の活動計画について